

2023年12月5日
TOPPAN 株式会社

TOPPAN、石川県能美市に次世代半導体パッケージの
開発・量産ラインを構築
JOLED 能美事業所の土地・工場を購入し、新拠点として活用

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、有機 EL ディ스플레이開発・製造の株式会社 JOLED(ジェイオーレド 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石橋 義、以下 JOLED)と、JOLED 能美事業所(所在地:石川県能美市)の土地・建屋の売買契約を2023年11月28日(火)に締結しました。

今後 TOPPAN は、JOLED から購入した能美事業所で、主にデータセンターのサーバー向けや生成 AI 向けの需要増などでさらに伸長が期待できる高密度半導体パッケージである FC-BGA (Flip Chip-Ball Grid Array) のさらなる高速伝送やチップレット(※1)に対応する次世代技術開発および量産ラインの構築を行い、2027年以降の稼働を予定しています。尚、本工場では TOPPAN の手掛ける既存のエレクトロニクス製品の生産も検討しています。



能美事業所の外観

■ 本売買契約締結の背景と狙い

社会の急速なデジタル化に伴い、データのトラフィック量は年々増加しています。このため 2.xD パッケージ(※2)など、高速大容量伝送に対応できる次世代半導体パッケージが注目されています。

TOPPAN は現在、新潟工場で FC-BGA の生産能力拡大を進めていますが、旺盛な需要に対して将

来的には新潟工場のみでは拡張余地がなく、新たな生産拠点の確保を検討していました。JOLED 能美事業所は、次世代半導体パッケージの製造工程に求められる条件を満たしており、このたび売買契約の締結となりました。

■ 概要

・取得対象

JOLED 能美事業所の土地および建物

・所在地

石川県能美市岩内町 1 番地 47、能美市苜生町 324 番地 2

・敷地面積

99,612.14 m²

・建屋面積

100,683.40 m²

・売買契約締結日

2023 年 11 月 28 日

■ 今後の展開

TOPPAN は今後次世代半導体パッケージの技術開発および量産ライン構築のための整備を進め、2027 年以降の稼働を目指します。新工場では、デジタルツイン(※3)、FA および AI 技術を活用し、省人化および生産効率の高い量産ラインを持つ最新鋭の工場として、スムーズな立上げを目指していきます。

※1 チップレット

大規模な回路を複数の小さなチップに個片化して1つのパッケージに収める技術

※2 2.xD パッケージ

チップと樹脂基板の間にインターポーザーと呼ばれる微細配線基板を有する半導体パッケージ

※3 デジタルツイン

現実空間のモノやデータをデジタル複製する技術

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上